

工程師培養計劃

世碩電子（昆山）有限公司

Summary

第一章

- ✓ 工程師培養總計畫
- ✓ 工程師培訓流程以及週期
- ✓ 工程師課程簡介
- ✓ 新人崗前技能考核

第二章

- ✓ 各技能等級的標準定義
- ✓ 展望未來

第一章，一.工程師培養總計劃

- 內部講師篩選/評估/認證
- 界定訓練標準及技能等級
- 盤點及梳理各技能等級匹配課程
- 建立技術職干部技能評鑒流程
- 技能認證隨縣考試
- 快修隨線考試
- 內部講師評級及激勵
- Level2、3、摸底考核
- 訓練計劃的擬訂、執行、追蹤
- 教材、教案編寫以及審訂
- 技能教材課程開講
- 開展技能等級評鑒活動by季度
- 新進staff訓練流程優化
- 晉升資格設定及導入
- 技能管理現場教學
- 完善培訓體系（制度化）

2016.11~2017.3

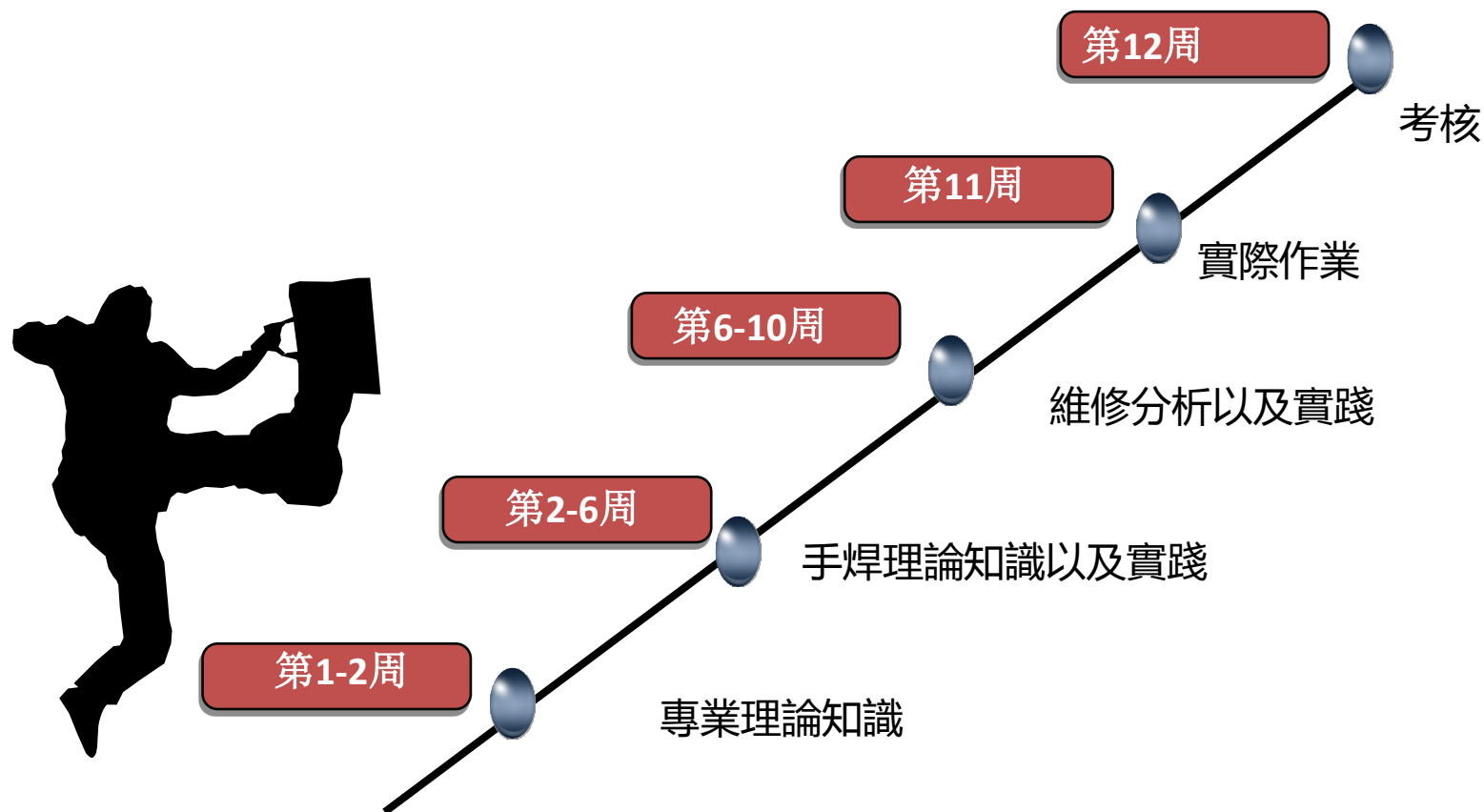
2017.4~2017.6

2017.7~ongoing

二.維修儲備幹部培訓流程以及週期



工程師培訓流程



三.工程師培訓課程簡介

序号	分类	課程	課時	分类	課程	課時
			(单位：H)			(单位：H)
1	专业理论知识	手机原理	2	维修分析及实践	EE現象以及實踐	40
2		基本名词的理解以及掌握	2		RF现象以及實踐	40
3		基础电路的讲解	2		KGB現象以及實踐	40
4		维修的基本流程	2		TOP現象SOP學習以及實踐	10
5		万用表及示波器使用	2	新人上線跟蹤	EE人員周修復率	40
6		各个站位的工作原理	4		RF人員周修復率	
7		各个站位的测试项目（13个站位）	39		KGB人員周修復率	
8		IC的理解与掌握	6			
10		BLOCK图的理解与掌握	6			
12		每个模块电路图的理解与掌握	8			

四.新人崗前技能考核

★考核要求

- **主板現象**：針對教育訓練所培訓的現象
- **主板狀態**：新板
- **主板數量**：20pcs
- **考核時間**：8H
- **考核地點**：各課提供統一考核地點

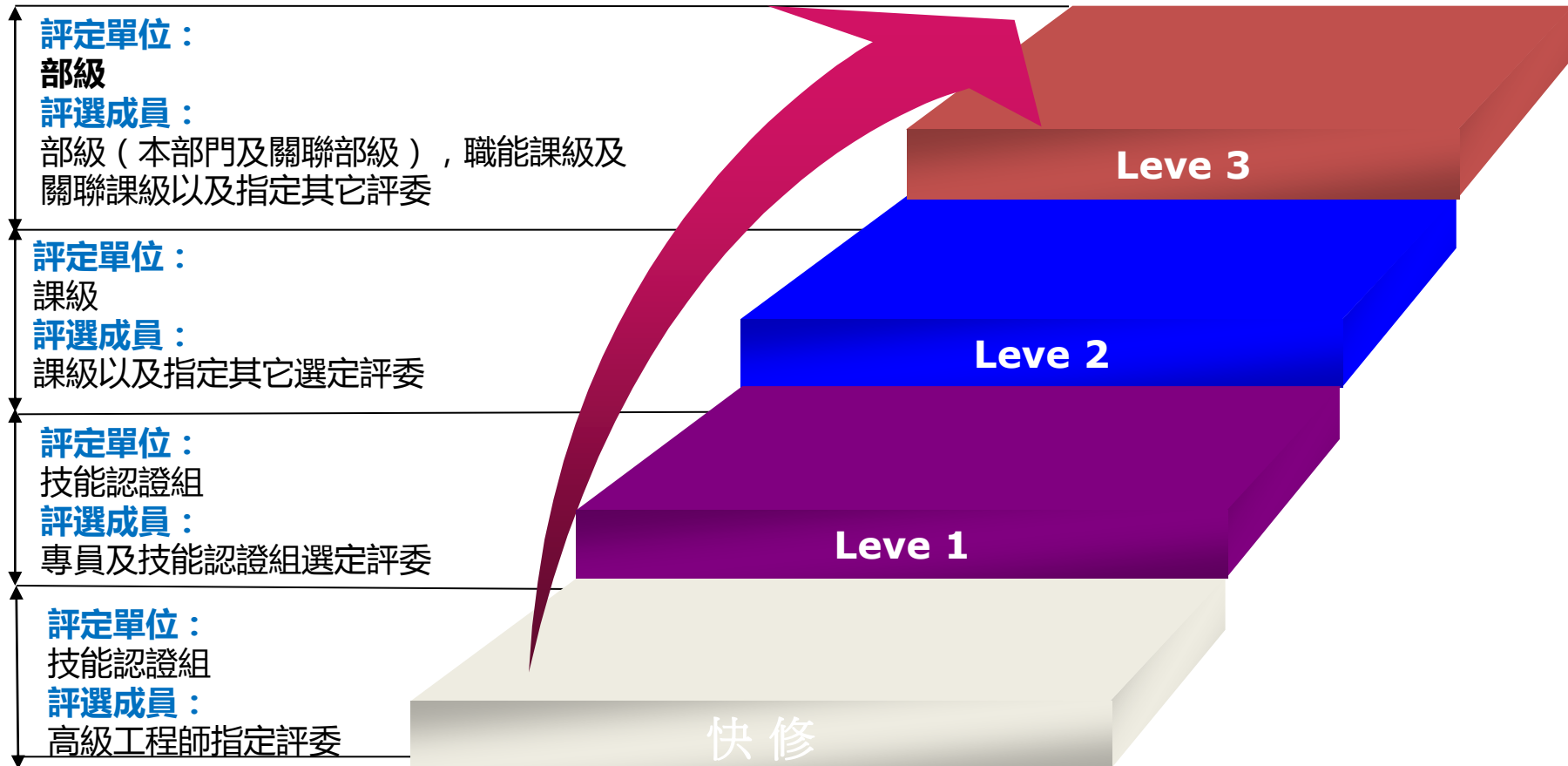
★通过标准

- ◆ **修復率**：EE通過良率：L1(EE)現有修復率*60%
- ◆ RF通過良率：L1(RF)現有修復率*70%
- ◆ KGB通過良率：L1(KGB)現有修復率*70%
- ◆ **異常**：燒機，發黴，掉點及維修判定異常的來料報廢現象可在拿到主板30min內給予換板。
- ◆ **判大料**：判 BGA (CPU,NAND,BB,WAIFI,PMU) 等料件，需寫明分析思路及所判料件，經由資深BGA工程師複判OK也可算pass
- ◆ **卡關站位**：EE---EE對應站位測試pass
- ◆ RF---RF對應站位測試pass
- ◆ KGB---KGB對應站位測試pass

第二章 一.各技能等級的評定標準一定義



二.各技能等級的評定標準-評定要求



三.各技能等級的評定標準-考核要求

L1

考核要求

主板現象：針對教育訓練所培訓的現象

主板狀態：新板

主板數量：20pcs

考核時間：8H

考核地點：各課提供統一考核地點

L2

考核規則

主板現象：不限

考核資格：L1組排名前10名人員。

狀態：L1修過一次的主板

主板數量：20pcs

時間：8H

考核地點：各課提供統一考核地點

L3

1.L2中前3名人員。

2.安排人員對指定的現象提供分析課件以及上課，學員綜合考評。

3.庫存板TOP5中任意挑選20 Pcs主板，進行分析

五.展望未來

- 內部講師評級及激勵措施
- By周安排工程師研討會并現場評鑒
- 制定并完善考核流程卡
- 將考核結果作為處理異常學習流程圖
- 潛力工程師訓練計劃推行及追蹤

Thank you !